



本社：〒160-8366

東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号

西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20061212004

2007 年 10 月 9 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 ビジネスオペレーションズ部
カスタマドキュメント マネージャ 牧 達郎 

8/10 ピン METAL CAN (LMC, LME) パッケージ製品 組立サイト変更のご案内

(初版 PCN20061212004 2006 年 12 月 25 日発行)

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきまして下記にご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)		☒ Final notice	
変更概要	Design/Specification	☐ Design	☐ Electrical	☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	☒ Assembly	☒ Site	☐ Process	☐ Material
	Test	☐ Site	☐ Process	
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling		☐ -
変更内容	8/10 ピン METAL CAN (LMC, LME)パッケージ製品 組立サイト変更 現行 : CEI 社(タイランド) 変更後: CEI 社(タイランド)及び HANA 社(中国)			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	11 月中旬の出荷より予定しています。			
品質認定試験	☐ 計画		☒ 終了	
製品表示	☐ 変更無し		☒ 変更あり	
備考	—			

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更内容

内容：弊社 HPA (ハイパフォーマンスアナログ) 8/10ピン METAL CAN (8LMC, 10LME) パッケージ製品について、現行、CEI社(タイランド)製造にて製造していますが、これに加えHANA社(中国)サイトでの製造を追加し認定しました。また、梱包材料に関しましては、各サイトで現行量産に適用いたしております部材の仕様となります。

変更内容
後工程製造サイト

現行
CEI社(タイランド)

変更後
CEI社(タイランド)
HANA社(中国)

理由：供給能力の確保の為

対象製品リスト

対象製品名				
4213BM	INA105BM	OPA128JM	OPA2111KM	OPA637BM
4213SM	INA117AM	OPA128KM	OPA445BM	OPA637SM
INA101AM	INA117BM	OPA128LM	OPA627AM	
INA101CM	INA117SM	OPA128SM	OPA627BM	
INA101SM	INA117SMQ	OPA2111AM	OPA627SM	
INA105AM	OPA111BM	OPA2111BM	OPA637AM	

製品表示

製品表示につきましては、組立サイトを示す LTC (Lot Trace Code) の“S”の箇所の記号が、現行“E”(CEI 社)から“9”(Hana 社)となります。

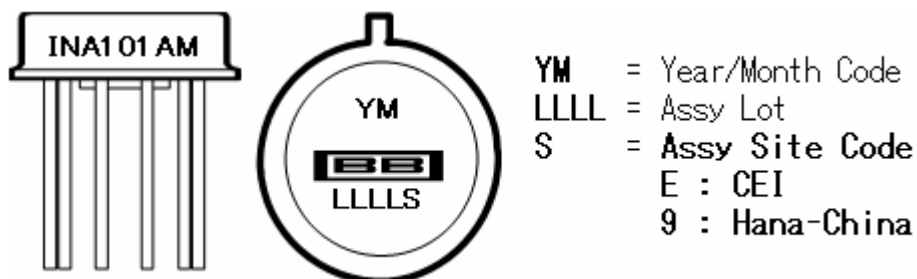


図1. 製品表示例

信頼性試験結果

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	2006 年 12 月	終了	2007 年 8 月 30 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qualification Device:	INA117BM		OPA627BM	
Die Rev/ Size(mils):	A (FBIPINA117P) / 85 x 103		5CIC02268LWP / 80 x 117	
Wafer Fab Site:	HFAB/TFAB		TFAB	
Technology:	Bi-POLAR		Bi-POLAR	
Fab Process:	HU-BIP-4 (630G)		452	
Passivation:	5kÅSiO2/8kÅSiON		5k LTO/8k SiON	
Metal1/ Resister Tech:	AlCu (0.5%) / SiCr		Al, 1% Si / NiCr	
Assembly Site:	HNC		HNC	
Package/ Pin count:	LMC TO99 / 8		LMC TO99 / 8	
Mount Compound:	ABLEB 84-1 LMISR4		ABLEB 84-1 LMISR4	
Bond:	1.25 mil Al		1.25 mil Al	
Down Bonds:	1		None	
L/F Composition/ Finish:	Au / Au		Au / Au	
Die Overcoat:	PI-2562		NONE	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		INA117BM	OPA627BM	
Steady-state Life Test	125C,1000hrs	116/0	120/0	
**High Temp. Storage Bake	150C, 1000hrs	-	120/0	
Solder Heat	260C, 10sec	-	9/0	
Solderability	Steam age, 8hrs	-	9/0	
Lead Fatigue	# of leads, min. 3 units	-	9/0	
Lead Pull	# of leads, min. 3 units	-	9/0	
PIND	Per PIND test Spec	-	25/0	
Die Shear	Per Mfg Site Spec	-	76/0	
Manufacturability	Per Mfg. Site specification	Approved	Approved	
Mechanical Stress	Shock , Limit to 10kg force	-	45/0	
	Vibration, Condition A	-	45/0	
	Constant Acceleration, Condition E	-	45/0	
	Fine and Gross leak	Per Mfg Site Spec	-	45/0
Visual	Post Fine and Gross leak test	-	45/0	
Final electrical @ ATE	F/E post Fine and Gross leak test	-	45/0	
Salt Atmosphere	24hrs	-	10/0	
X-Ray Inspection	Per Assembly Site spec	-	15/0	
Visual / Mechanical	Per Spec	-	75/0	
Internal Water Vapor	5000PPM @100C 3 with 0 fails or 5 with 1 fail	-	3/0	
**- Samples used to populate these tests must be preconditioned per the appropriate sequence.				

** - Samples used to populate these tests must be preconditioned per the appropriate sequence.